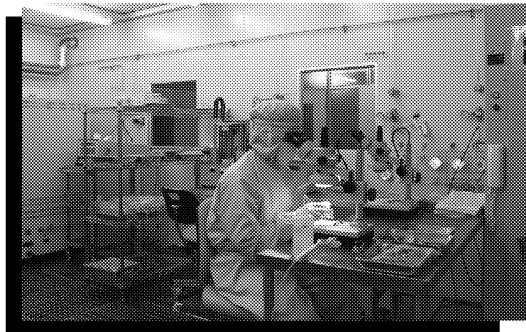


NASclean®
超精密ガスフィルター

Micro&Fine Technologyで 次代に躍進



製品群

- ・小流量～大流量 (1SLM～20,000Nm³/h)
- ・集積フィルター (W シール、C シール、他)
- ・ガasketフィルター (1/4"、3/8")
- ※材質: SUS、ハステロイ、純 Ni、PTFE
- ・高速ベントフィルター (半導体、液晶向け)

お問い合わせ: semicon@n-seisen.co.jp

大同特殊鋼グループ
日本精線株式会社

本社〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 4-1-1 TEL.06-6222-5439 FAX.06-6222-1250
<http://www.n-seisen.co.jp>

Assembly & Packaging - パッケージング工程に関するスタンダード

G88-0211	Specification for Tape Frame for 450 mm Wafer / 450mmウエハー用テープフレームの仕様
G92-1113	Specification for Tape Frame Cassette for 450mm Wafer / 450mmウエハーのためのテープフレームカセットの仕様
G95-0613	Mechanical Interface Specification for 450 mm Load Port for Tape Frame Cassettes in the Backend Process / 後工程のテープフレームカセット用450mmロードポートのメカニカルインターフェースの仕様

Physical Interfaces & Carriers - 半導体製造分野に関するスタンダード

E83-0413	Specification for PGV Mechanical Docking Flange / PGVメカニカルドッキングフランジの仕様
E154-0713	Mechanical Interface Specification for 450 mm Load Port / 450 mm ロードポートのためのメカニカルインターフェースの仕様
E156-0710	Mechanical Specification for 450 mm AMHS Stocker to Transport Interface / 移送のための450 mm AMHS (自動搬送システム) 用ストックのインターフェースのメカニカル仕様
E158-0912	Mechanical Specification for Fab Wafer Carrier Used to Transport and Store 450 mm Wafers (450 FOUN) and Kinematic Coupling / 450mmウエハー搬送および保管用のウエハーキャリア (450FOUP) とキネマティックカップリングのメカニカル仕様
E159-0912	Mechanical Specification for Multi Application Carrier (MAC) Used to Transport and Ship 450 mm Wafers / 450mmウエハーの搬送および、搬送のための多目的キャリア (MAC: Multi Application Carrier) のメカニカル仕様
E162-0912	Mechanical Interface Specification for 450 mm Front-Opening Shipping Box Load Port / 450mmフロントオープニング・ SHIPPINGボックス・ロードポートのためのメカニカルインターフェースの仕様
E166-0513	Specification for 450 mm Cluster Module Interface: Mechanical Interface and Transport Standard / 450mmクラスターモジュールインターフェースのための仕様: メカニカルインターフェースおよび搬送スタンダード
AUX023-1113	Overview Guide to SEMI Standard for 450 mm Wafers / 450mmウエハーに関するSEMIスタンダード全体ガイド

Silicon Wafer - シリコンウエハーに関するスタンダード

M1-0114	Specification for Polished Single Crystal Silicon Wafers / 鏡面単結晶シリコンウエハーの仕様
M49-0613	Guide for Specifying Geometry Measurement Systems for Silicon Wafers for the 130 nm to 16 nm Technology Generations / 130nm から16nmへの技術世代のシリコンウエハー用ジオメトリ測定システム規定のためのガイド
M52-0214	Guide for Specifying Scanning Surface Inspection Systems for Silicon Wafers for the 130nm to 11nm Technology Generations / 130nmから11nm技術世代シリコンウエハー用走査型表面検査装置仕様のためのガイド
M62-0413	Specifications for Silicon Epitaxial Wafers / シリコンエピタキシャルウエハーの仕様
M73-1013	Test Methods for Extracting Relevant Characteristics from Measured Wafer Edge Profiles / 測定したウエハーのエッジプロファイルから直接的関連性ある特性を抽出する試験方法
M74-1108 (Reapproved 0413)	Specification for 450mm Diameter Mechanical Handling Polished Wafers / 450mmメカニカルハンドリング鏡面ウエハーの仕様
M76-0710	Specification for Developmental 450mm Diameter Polished Single Crystal Silicon Wafers / 開発用直径450mmシリコン単結晶鏡面ウエハーの仕様
M80-0812	Mechanical Specification for Front-Opening Shipping Box Used to Transport and Ship 450mm Wafers / 450mmウエハーの搬送および出荷用フロントオープニング・SHIPPINGボックスの機械仕様

2014年1月にアップデートされた450mmウエハー関連のSEMIスタンダード (SEMI発表資料より作成)

半導体ソリューション
Electronic Components Solutions

ITソリューション
Information Technology Solutions

インレビウムソリューション
inrevium Solutions

技術力と提案力でエレクトロニクス商社No.1をめざします

東京エレクトロデバイス

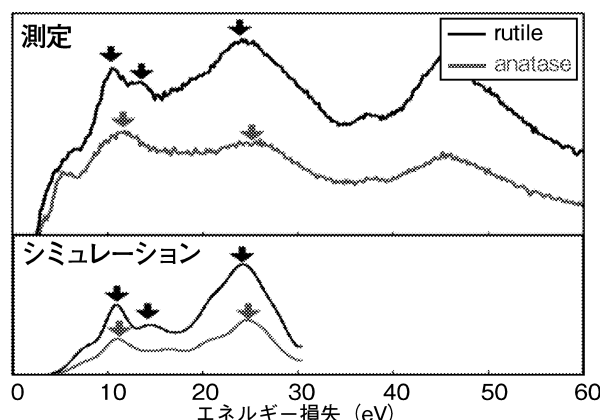
私たち東京エレクトロデバイスは、世界中から最先端の半導体やIT機器を調達し、的確なソリューションを提供する「提案力」と、お客様ごとに最適かつ高度な設計・開発・サポートを行う「技術力」で、お客様にとってかけがえのないビジネスパートナーをめざしています。

取り扱い商品: 電子部品事業 ● 半導体製品/ソフトウェア ● 電子部品ほか ● インレビウム (設計受託/量産受託/自社ブランド商品) ● コンピュータ・ネットワーク事業 ● ネットワーク/ストレージ/ミドルウェア

東京エレクトロデバイス株式会社

〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地4 横浜イーストスクエア TEL.045-443-4000(代表)
<http://www.teldevice.co.jp>

半導体デバイスと製造装置



電子エネルギー損失分光法 (EELS) の外殻電子励起スペクトルと損失関数 (材料科学技術振興財団提供)

新材料の利用。さらなる微細化や高集積化に向けた技術開発が行われていく中で、メーカーが解決に取り組みなければならぬ課題は、標準サンプルを用意したりして、そのデータと比較することによって解析を行うこと。しかし、最先端の材料ではライブラリがない場合や狙った構造でサンプルを作ることができない場合があるという。最先端の受託分析サービスを提供し、日本の半導体の研究開発をサポートしてきた材料科学技術振興財団 (MST) の分析評価部 T.M.G 営業担当リーダーである佐々木達郎氏は、「そういった場合、計算科学、つまりシミュレーションを利用したデータ解析を行うことで、より詳細な解析結果を得ることができる」と語る。同財団では11年にスーパーコンピュータ (スパコン) を導入し、シミュレーション解析を行う。日本の半導体はその高品質で、世界市場から好評を得てきた。その品質を支えてきたのは、メーカーの徹底した生産管理に加えて、研究開発時の計測や分析、さらには解析・評価が高いレベルで行われてきたから。微細化、高集積化、新材料の導入など、これからさらに進展していく次世代半導体というモノづくりにおいて、計測や観察、構造分析、評価の役割はこれまで以上に高まる。

進化する解析技術

開発スピードアップ

新材料の利用。さらなる微細化や高集積化に向けた技術開発が行われていく中で、メーカーが解決に取り組みなければならぬ課題は、標準サンプルを用意したりして、そのデータと比較することによって解析を行うこと。しかし、最先端の材料ではライブラリがない場合や狙った構造でサンプルを作ることができない場合があるという。最先端の受託分析サービスを提供し、日本の半導体の研究開発をサポートしてきた材料科学技術振興財団 (MST) の分析評価部 T.M.G 営業担当リーダーである佐々木達郎氏は、「そういった場合、計算科学、つまりシミュレーションを利用したデータ解析を行うことで、より詳細な解析結果を得ることができる」と語る。同財団では11年にスーパーコンピュータ (スパコン) を導入し、シミュレーション解析を行う。日本の半導体はその高品質で、世界市場から好評を得てきた。その品質を支えてきたのは、メーカーの徹底した生産管理に加えて、研究開発時の計測や分析、さらには解析・評価が高いレベルで行われてきたから。微細化、高集積化、新材料の導入など、これからさらに進展していく次世代半導体というモノづくりにおいて、計測や観察、構造分析、評価の役割はこれまで以上に高まる。

プロセスと材料

YASKAWA



7つを極めた 心ゆさぶる ソリューション

高速スキャン設定 最小125μsを可能とした新マシンコントローラMP3300。
速度周波数応答3.1kHzを実現するACサーボドライブ7シリーズ。
「7つを極める」をキーワードに誕生した新製品が、驚きの高性能とともに、スペックだけでは語れない一歩先ゆくソリューションを提供します。

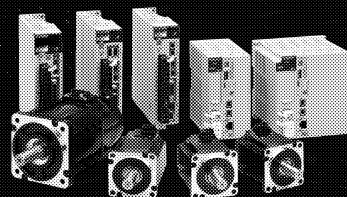


株式会社 安川電機

東京支店 東京都港区海岸 1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー 8F 〒105-6891 TEL.(03) 5402-4502
大阪支店 TEL.(06) 6346-4500 / 名古屋支店 TEL.(052) 581-2761 / 九州支店 TEL.(092) 714-5331
製品・技術情報サイト <http://www.e-mechatronics.com> オフィシャルサイト <http://www.yaskawa.co.jp>

e-motional
solution

マシンコントローラ MP3300
&
ACサーボドライブ7シリーズ



新発売!